

新製品紹介

zSFP+ スタックインター コネクト SFP56

- 28G NRZ信号と56G PAM-4信号の両方をサポート
- 基板対基板スペースの最大化



TEのzSFP+スタックインターコネクトは、ハイパースケールデータセンターやネットワーキング・スイッチ・アプリケーション向けに高いフェースプレート密度を提供しながら、最大56 Gbps PAM-4のデータ転送レートを実現するよう設計されています。

スタック製品ポートフォリオは、高密度化を実現し、基板スペースを最大限に節約するために、3列のベリー・ツー・ベリーのアプリケーションに対応できます。

主な利点

- I/OインターコネクトのSFPポートフォリオの各製品は、最大28Gbps NRZおよび56Gbps PAM-4信号の速度でデータを転送するように設計されています。
- スタック製品ポートフォリオは、高密度化を実現し、基板スペースを最大限に節約するために、3列のベリー・ツー・ベリーのアプリケーションに対応できます。
- SFP28ポートフォリオ全体と同じ統合インターフェースとケーシング寸法を共有
- 28Gbpsアプリケーションから56Gbpsアプリケーションへのシンプルなアップグレードパスを実現。
- 強化されたエアフローケーシング設計は、優れた熱性能を提供し、カスタマイズ可能。また、LEDライトパイプに対応。

詳細

[zSFP+ 製品ページ](#)

[zSFP+ クイック・リファレンス・ガイド](#)

[zSFP+ 型番リスト](#)

アプリケーション

- スイッチ
- サーバー
- ルーター
- ストレージ
- 試験装置

電気的特性

- データレート(最大)56 Gbps

機械的特性

- 基板実装方式:スルーホールプレスフィット
- コネクタ実装タイプ:基板

ハウジング

- ピッチ:0.6mm

zSFP+およびzQSFP+は、ZXP製品シリーズの一部であり、ZXPテクノロジーを使用しています。ZXPはMolex LLCの商標です。TE Connectivity、TEおよびTE connectivity(ロゴ)は商標です。